

弘塑科技股份有限公司

Grand Plastic Technology Corporation

法人說明會

Company Introduction

2009年5月20日



INDEX

1. 概況

- 1) 關於弘塑
- 2) 公司變革
- 3) 經營團隊簡介
- 4) 經營績效
- 5) 工廠概況

2. 產品簡介

- 1) 設備認證Semi S2-0200
- 2) 產品簡介

3. 市場分析

- 1) 利基市場
- 2) 客戶
- 3) 競爭對手
- 4) 競爭優劣分析

4. 產業前景及目標

- 1) 未來封裝的市場成長
- 2) 產業前景及目標

1. 概況 1) 關於弘塑 (About GPT)

- 創立：1993年 5月.
- 資本額：NT 2 億
- 員工數：85 人.
- 認證：ISO 9001:2000 (Mar, 2002)
- 主要產品：濕製程設備



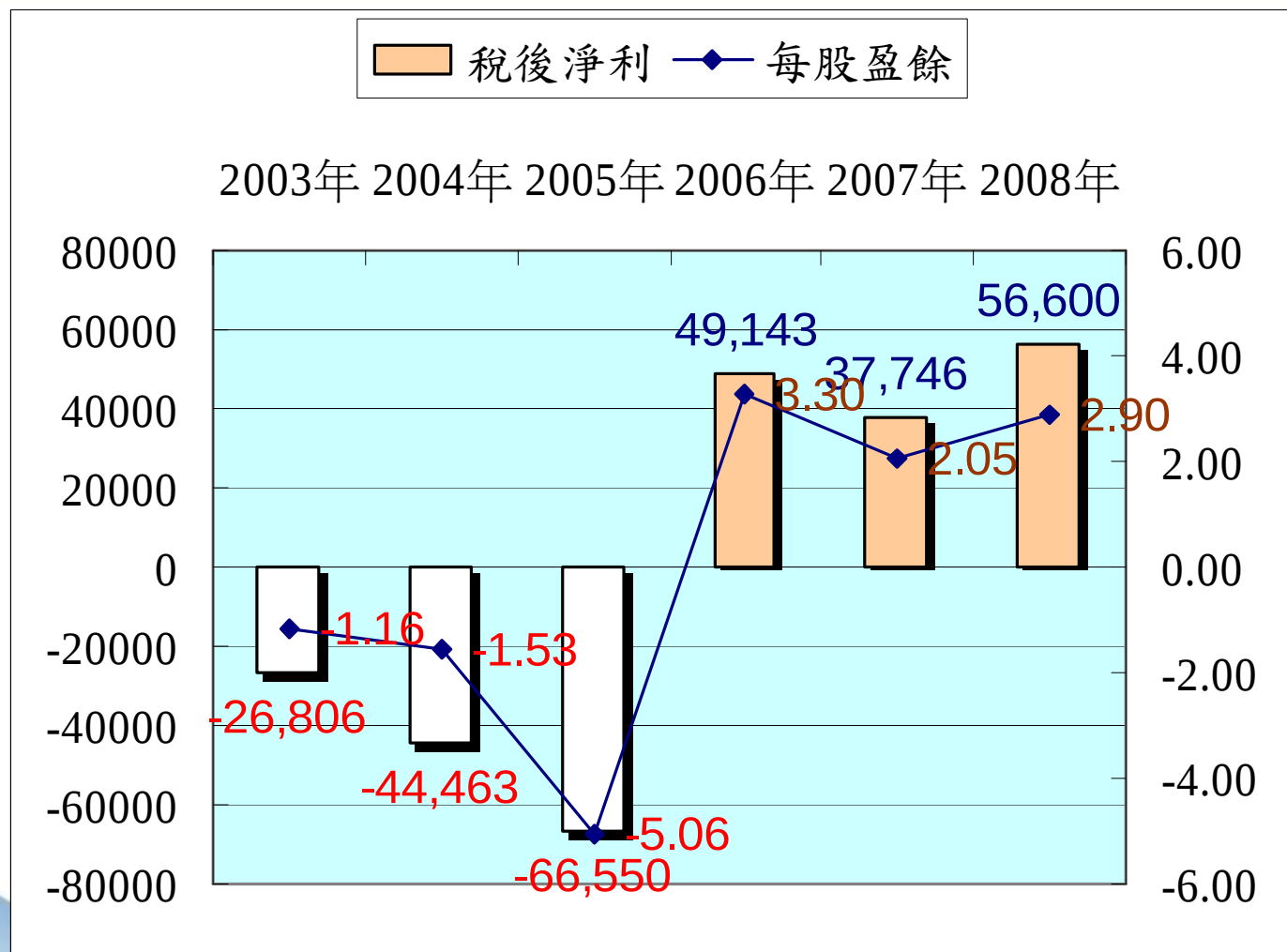
1. 概況 2) 公司變革 (Mile Stone)

- 1993年 5月：弘塑科技有限公司成立，額定資本額3,000仟元。
- 1999年 1月：經DNV認證公司稽核取得ISO 9002認證資格。
- 1999年 9月：開發出第一台8吋單晶圓濕式旋轉清洗設備。
- 2000年 5月：遷入新廠－新竹縣湖口鄉大同路13號(現址)。
- 2000年 9月：開發出第一套12吋全自動濕式晶圓清洗設備及第一套12吋單晶圓濕式清洗設備。
- 2002年 3月：經SGS認證取得ISO 9001資格。
- 2002年 9月：取得Semi S2-200認證。
- 2005年11月：開發出第一套銅電鍍(Cu plating)機台。
- 2005年 9月：開發出第一套鎳電鍍(Ni plating)機台。
- 2006年 8月：開發出第一套化鍍(electro-less plating)機台。
- 2008年 9月：證期局核准公開發行，證券代號3131。
- 2009年5月：5/8本公司獲櫃買中心核准登錄興櫃。

1. 概況 3) 經營團隊簡介

姓名	職稱	學歷	科系	經歷
張鴻泰	董事長	華夏工專畢	電機科	現任佳霖科技董事長
詹印豐	總經理	University of Missouri-Columbia 台灣工業技術學院	E.E. 電子系	ETEC Japan，佳霖科技、聯華電子， Micronic Laser System
顏錫鴻	副總經理	華夏工專畢 中原大學肄	機械科 土木系	帆宣科技/工程師
施炳煌	財務部經理	淡江大學畢	會計系	東帝士東雲(股)、台灣光寶電子(股)、昱 泉國際(股)、滾石魔岩唱片/財務長
蔡漢平	業務部經理	明新科技大學	國貿系 電子科	米輯科技/前段設備工程師、華邦電子/蝕 刻設備工程師
張修凱	客服部經理	中華大學畢	工管系	寰邦科技
黃文翰	設計開發部 經理	台灣大學	機械所	博磊科技、KLA-Tencor/Novellus 、鈦昇科技、工研院/機械所
劉文明	生產技術部 經理	明新工專畢	機械工程科	亞葳機電/設計/品保組長
莊少杰	資材部經理	文化大學	電機系	司熱高科技/採購主管、元太科技/採購課 長、東菱通信/採購課長
林惠敏	行政部經理	英國曼徹斯特大學畢 輔仁大學畢	成人教育研究所 社會學系	埔里基督教醫院/管理師、資策會/規劃 師、研華/高級專員、遠鼎建設/專員

1. 概況 4) 經營績效



1. 5) 工廠概況



辦公室

■ Planning



Class-10
RD 實驗室

■ Testing



Class-10,000 組裝區

■ Production

2. 產品簡介 1) Semi S2-0200 (Equipment Safety Guide Line)



SEMI Standard S2-0200
Batch type Wet Bench

Certificate		TÜV	
Certificate no. WA 50016173 01			
Applicant: Grand Plastic Technology Corporation No.13, Ta Tung Road Hsinchu Industrial Park Hsinchu 303 Taiwan, R.O.C.		Manufacturer: Grand Plastic Technology Corporation No.13, Ta Tung Road Hsinchu Industrial Park Hsinchu 303 Taiwan, R.O.C.	
Test report no.: ZFW5.080 11000232 001		Client Reference: P.F.	
Tested to: EN 775:1992 NFPA 79:1997 SEMI S2-0200 SEMI S8-0701			
Test object: Wet Etcher Licence For - Use Type Designation: GPTC-50 Rated Voltage: AC 208V, 3 Phases, 50Hz Rated Current: 125A			
Licensed Test mark: 		TÜV Rheinland Taiwan Ltd. Signature: 	
		Date of Issue (day/month): 21.08.2002	



SEMI Standard S2-0200
Single wafer processor

SGS		SGS Korea Co., Ltd.	
811122F Chungnam Bldg. 30-20, Gafan-dong, Tongseong-Myo Seoul, 140-100 Korea Telephone : +82 (0) 708 4326 Fax : +82 (0) 708 4326		Product Certificate Division Serial No. 6901/ 950985	
LETTER OF COMPLIANCE			
Name of Manufacturer: Grand Plastic Technology Corporation Address of the Manufacturer: #13, Ta-Tung Road, Hsin Chu Industrial Park Taiwan R.O.C. Name of the System: Single Wafer Spin Processing System Type of the Equipment: GPTC-UFO Report No.: S-45/02-0129 Date of Letter Issue: September 9, 2002			
The results of the safety evaluation and test of the system GPTC-UFO are found to be compliant with the applicable requirements of SEMI Standard S2-0200 Product Safety Guidelines and SEMI S8-1000 Safety Guidelines for Ergonomics/Human Factors.			
Windsor Kim / Manager Product Certificate Division SGS Korea Co., Ltd.			
This certificate is issued by the Company under its General Conditions for Inspection and Testing Services, printed overleaf. The validity of this Certificate does not entitle the signatory to exercise all their rights and discharging all their liabilities under the Contract of Sale. Situations to the contrary are not binding on the Company. The Company's responsibility under this Certificate is limited to proven negligence and will in no case be more than ten times the amount of the fee or remuneration, except by special arrangement, samples, if shown, will not be retained by the Company for more than three months.			

2. 2) 產品簡介



Wet Bench



Single Wafer Processor



Mask Cleaner



Electroless plating



Electroplating

Batch type Wet Bench (Auto)

200mm Auto Bench



Features

- I SEMI S2-200 Qualified
- I GEM / CIM / SECS-II Available
- I 8" Wafer Application

Applications

- I RCA Clean
- I Nitride Strip
- I Metal Etching
- I PR Strip

300mm Auto Bench



Features

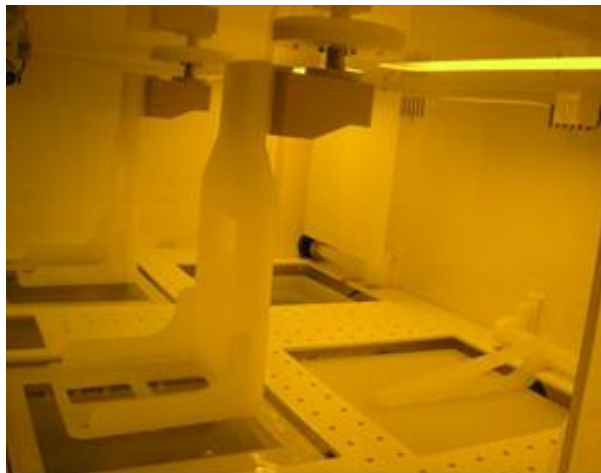
- I SEMI S2-200 Qualified
- I GEM / CIM / SECS-II Available
- I 12" Wafer Application

Applications

- I Wafer Reclaim
- I DFR Strip
- I LFR Strip

Batch type Wet Bench (Semi-Auto/Manual)

150/200mm Semi-Auto Bench



Features

- I GEM / CIM / SECS-II Available
- I 6/8" Wafer Application
- I Small Footprint

Applications

- I Clean process
- I Etching process
- I Stripping process

150/200mm Manual Bench



Features

- I Small Footprint
- I 6/8" Wafer Application
- I Low Cost

Applications

- I Clean process
- I Etching process
- I Stripping process

Batch type Wet Bench (Electroplating / Manual type)



Features

- I Cost Effective
- I Consecutive Plating Quality
- I Multi-Chambers Design

Typical Applications

- I Plating Ni/Cu
- I UBM, Re-distribution Wiring layer.
- I MEMS Component

Single Wafer Spin Processor (UFO)



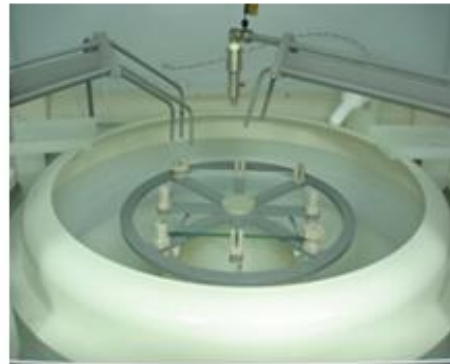
Features

- I SEMI S2-200 Qualified
- I GEM / CIM / SECS-II Available
- I 4", 5", 6", 8", 12" Application
- I Chemical Recycle Function

Typical Applications

- I Metal Etching
- I Wafer Clean
- I Flux Clean /Coating
- I PR Develop

Mask Cleaner (Spin Processor)



Features

- I For 4", 5", 6", 7", 8", 9", 12", 14" Mask Application
- I Chemical Recycle Function
- I Multi-Chemical Process

Central Chemical Supply System & CDM



- I Turnkey Central Chemical Supply System Project
- I Chemical Delivery Module: Local CDM; CCSS
- I Chemical Mixing System: SC1 , SC2, DHF & Customer Design
- I Slurry Delivery Mixing System

3. 市場分析 1) 利基市場

佔營收比例

前段半導體客戶：3~6%

後段CSP 封裝：75~85 %

其它：10~20 %

3. 市場分析 2) 主要客戶群



3. 市場分析

2001~09 年度 Install Base

ITEM	Q'ty	概估市佔率
CDM	16	
Semi-auto or manual wet bench	>200	
Back end 200 mm auto wet bench	29	70~80%
300 mm Dry Film Stripper	17	100%
Back end single wafer processor	21	40%

3. 市場分析 3) 競爭對手 (依地區分)

- 國外廠商

SEZ (奧地利)

SSEC (美國)

Semitool (美國)

SET (日本)

- 國內廠商

松展

辛耘

3. 市場分析 3) 競爭對手 (依機台應用分)

- **Back end 200/ 300mm 單晶片設備**
 - SEZ (奧地利)
 - SSEC (美國)
 - Semitool (美國)
- **200mm auto Wet Bench**
 - SET
- **300mm Wet Bench 乾膜去除**
 - 無
- **Semi-auto, manual Wet Bench**
 - 松展
 - 辛耘

3. 市場分析 4) 競爭優劣分析

- 國外廠商

優勢：

多樣化、靈活、服務、價格。

劣勢：

製程經驗不足。

- 國內廠商

優勢：

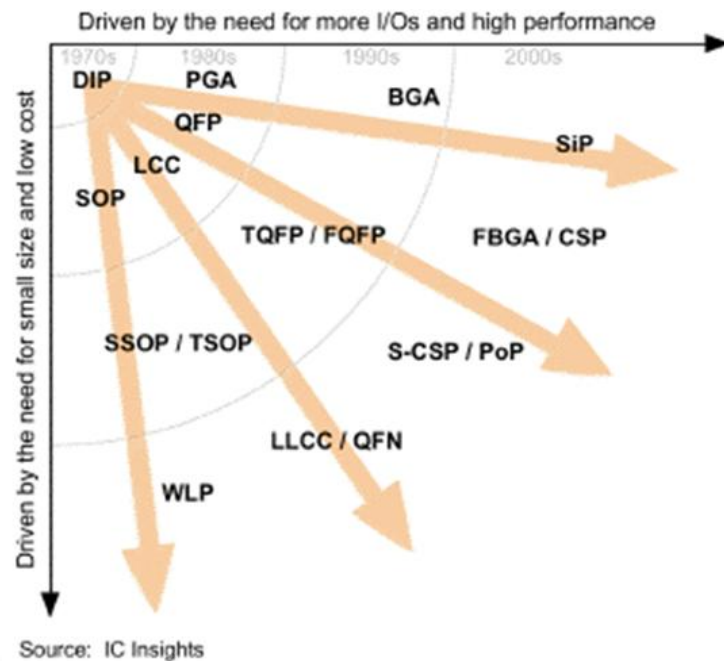
品質、製程經驗、服務。

劣勢：

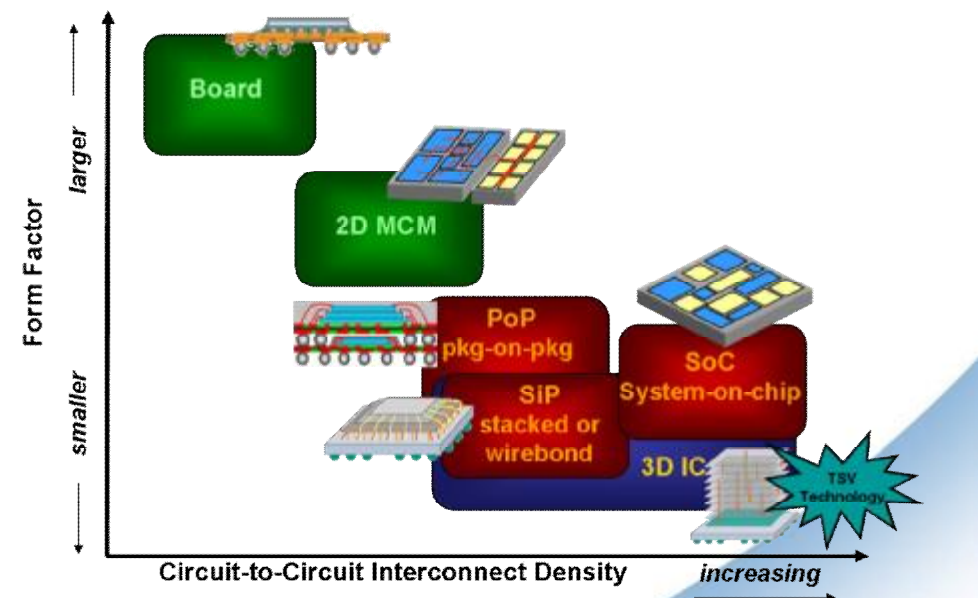
價格。

4. 產業前景與目標 1) 未來封裝的市場成長

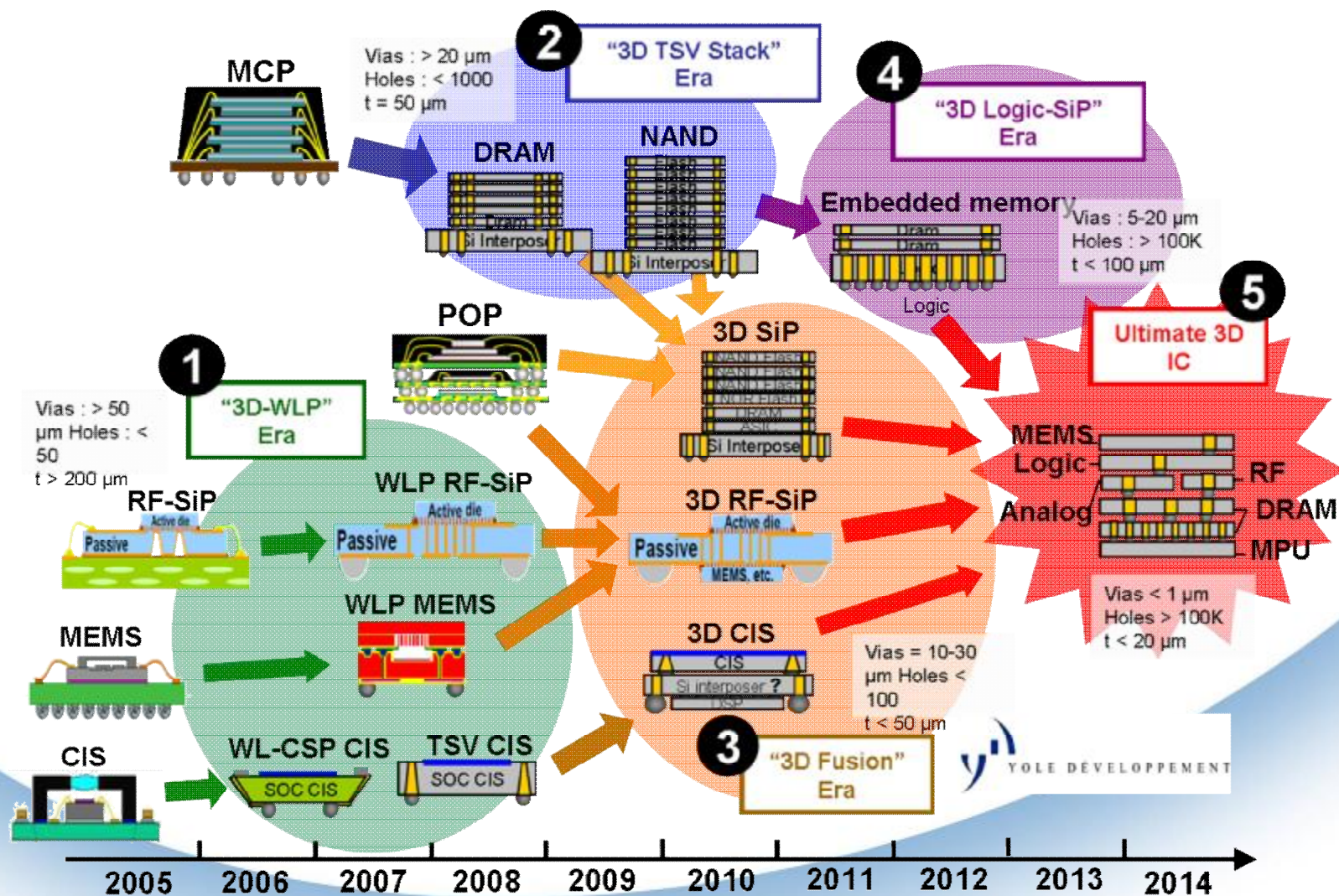
The Evolution of IC Packaging



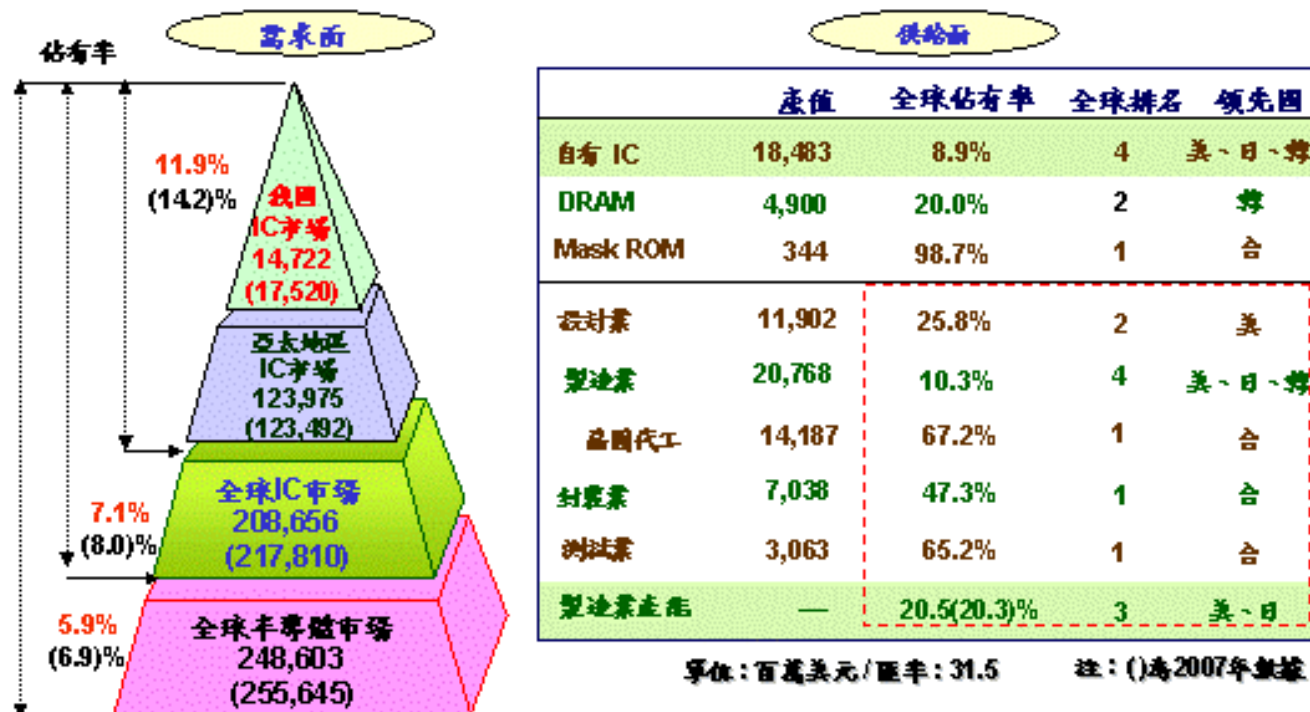
3D System Integration Landscape: Reducing the form factor



3D interconnect Technology Roadmap



2008年台灣IC產業與產品在全球的地位



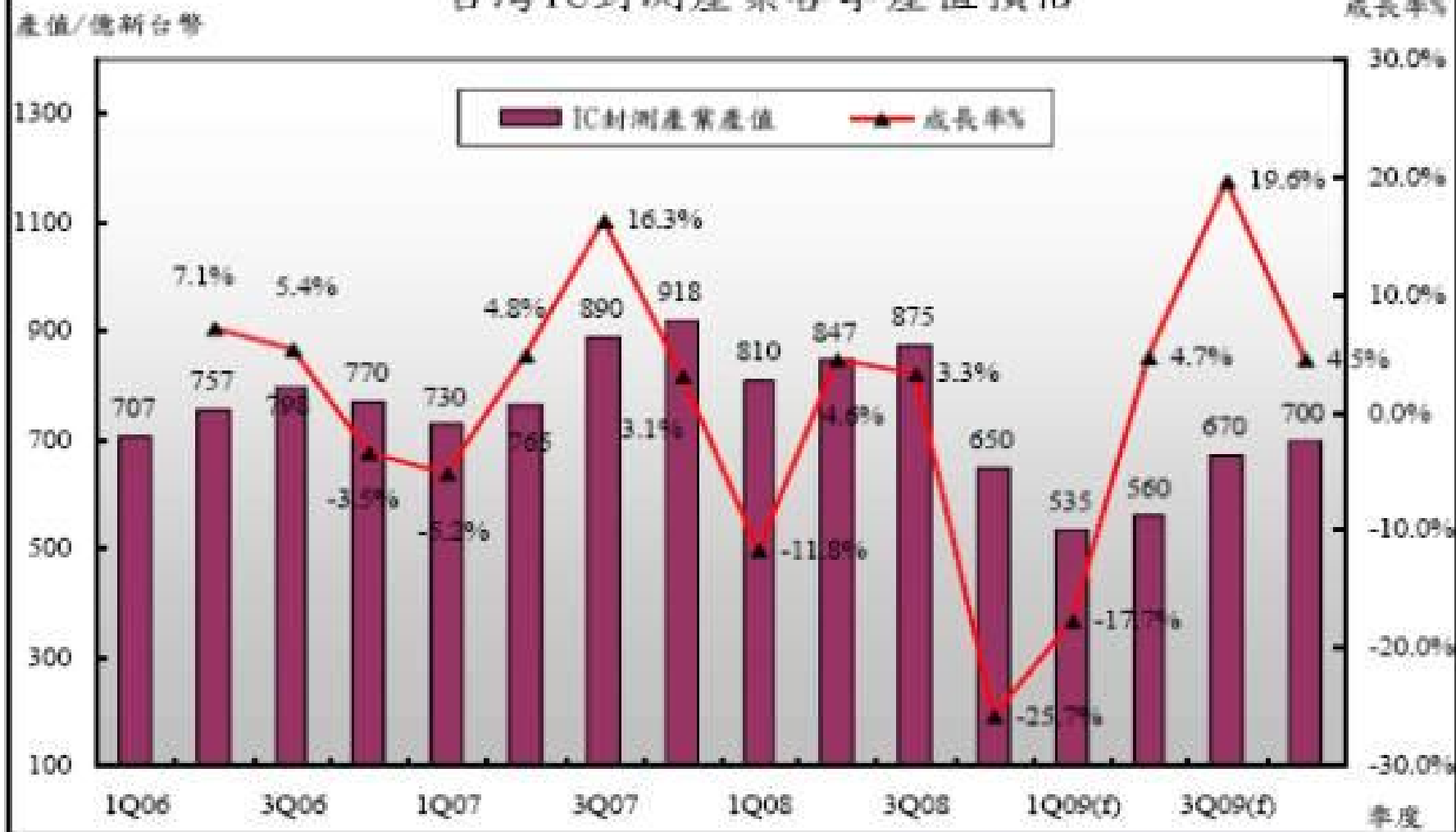
- 全球電子系統產品製造重心轉至中國，中國IC市場大幅成長，因此2008年台灣IC市場佔亞太市場比重從14.2%下降為11.9%，佔全球IC市場從8.0%下降為7.1%
- 我國IC自有產品中，產值最大的是DRAM，全球排名僅次於韓國
- 晶圓代工全球第一，2008年佔67.2%

資料來源：IHS/STS, 元研院(EK)(2008/2)

Copyright © 2008 ITR/江南大學研究發展

Grand Plastic Technology Corporation

台灣IC封測產業各季產值預估



資料來源:IEK/IBTS整理預估

此圖乃本公司內部文件，僅供內部參考，不得對外公開，請投資人依據個人專業判斷，本公司不作任何資訊及獲利保證。

4. 2) 產業前景與目標

1. 全球 5 大 CSP, WLP 封裝廠(ASE, Amkor, Spil, SCT, tsmc)皆在台灣。有助於弘塑的未來的成長。
2. 長期的競爭策略是以發展利基市場及利基產品為導向。專注於客戶的特殊應用。運用地理優勢及公司RD資源，緊密結合客戶的需求，以達成利基產品的市場佔有率及獲利率。
3. 2009年由於客戶產能利用率的下降，對設備商形成嚴峻的考驗。許多國外大廠也都陸續傳出經營困難的消息。在此情況下，弘塑是以尋找利基產品及利基市場為主要的策略。而事實證明，在這一波不景氣中，弘塑反而更容易找到國外大廠所不能或不願進入的利基市場。
4. 2009年的目標為，擴展與 TSV封裝製程有關之設備，如金屬化鍍設備。及針對其它產業如石英振盪器，TFT-LCD等所使用之特殊濕製程設備。

Q & A

